****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

**

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

**congatec launcht Intel® Atom™ C3000 Prozessor basierte
COM Express Typ 7 Server-on-Module (Codename Denverton)**

**Neue congatec Module mit 10 GbE Bandbreite setzen neue Maßstäbe im Embedded Edge-Computing**

**Deggendorf, 12. September, 2017 \* \* \*** congatec – ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer und Embedded Design & Manufacturing Services – stellt mit den conga-B7AC neue COM Express Typ 7 basierte Server-on-Module auf Basis der Intel® Atom™ C3000 Prozessoren vor, die mit ihrem 10 GbE Support neue Maßstäbe im Embedded Edge-Computing setzen. Mit einer Leistungsaufnahme, die bei nur 11 Watt startet, bieten die neuen Low-Power Server-on-Module bei bis zu 16 Cores bis zu 4x echtzeitfähige 10 GbE Netzwerkperformance. Das Featureset ist auf modulare Mikroserver für den industriellen Einsatz sowie robuste Telekom- und Netzwerkausrüstung – wie Small Cells, Factory-Gateways und Storagesysteme – ausgelegt und ermöglicht sogar den Einsatz im erweiterten Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C. Das conga-B7AC basierend auf der neuen COM Express 3.0 Spezifikation der PICMG ist als standardisierter Building-Block verfügbar und perfekt für die effiziente kundenspezifische Entwicklung von sehr kompakten, ausschließlich passiv gekühlten Embedded Edge-Devices geeignet.

“Verteilte Embedded Edge-Devices mit 10 GbE-Bandbreite können sowohl in Small Cells für die LTE-Netze der nächsten Generation als auch in Gerätenetzwerkknoten für cybervirtuelle Fabriken oder als lokale Mikro-Rechenzentren für Sensor-Netzwerke eingesetzt werden. Dabei müssen sie extreme Bandbreiten bei der TCP/IP-Kommunikation und Datenspeicherung verarbeiten können. Zudem müssen diese Edge-Rechenzentren eine hohe Multicore-Performance bieten, da sie in der Regel viele kleinere Paketgrößen parallel zu verarbeiten haben. Für genau diese Anwendungsbereiche sind die neuen Intel Atom C3000 Serverprozessoren die perfekte Ergänzung unseres Intel Xeon D Prozessor basierten Server-on-Module Portfolios. Durch reduzierte Kosten und geringeren Stromverbrauch können wir nun sehr hohe Netzwerkbandbreiten und Storage-Kapazitäten bis tief in das industrielle Feld ausrollen“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec.

Die neuen COM Express Typ 7 Server-on-Module von congatec sind applikationsfertig für Redundanz, Echtzeitkommunikation und Virtualisierungstechnologien, um die Betriebsdauer und Resilienz zu maximieren, Latenzen zu minimieren und das Maximum aus jedem einzelnen Prozessorkern herauszuholen. Mit ihrem Cloud-API für dezentrale Edge-Server bieten sie zudem all die Funktionsmerkmale, die Rechenzentrums-Manager benötigen, um den Systemstatus, Stromverbrauch und weitere Umgebungsvariablen fernüberwachen zu können. Mit Support von bis zu 20 PCI Express (PCIe) Lanes bieten die neuen Intel Atom C3000 Prozessor basierten COM Express Typ 7 Server-on-Module zudem minimale Latenzen für Speichersysteme sowie extrem schnellen Zugriff auf all die unterschiedlichen Sensornetzwerke, Feldbusse und industriellen Ethernets.

**Das Featureset im Detail**

Die neuen conga-B7AC COM Express Typ 7 Server-on-Module sind mit 8 verschiedenen Intel® Atom™ Serverprozessoren verfügbar – vom 16 Core Intel® Atom™ Prozessor C3958 bis zum Quadcore C3508 für den erweiterten Temperaturbereich (-40 °C bis +85 °C). Alle Module bieten bis zu 48 GB schnellen 2400 DDR4 Speicher, der je nach Kundenanforderungen mit oder ohne Error Correction Code (ECC) ausgelegt ist. Mit bis zu 4x 10 GbE bieten sie extrem hohe Netzwerkbandbreite und ihre Network Controller Sideband Interfaces (NC-SI) erlauben über den Anschluss eines Baseboard Management Controllers (BMC) das Out-of-Band Management. Flexible Systemerweiterungen inklusive NVMe Flash-Speicher können über bis zu 12x PCIe gen 3.0 und 8x PCIe Gen 2.0 Lanes angebunden werden und konventionelle Speichermedien über 2x SATA 6G. Zu den weiteren I/O-Schnittstellen zählen 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, LPC, SPI, I2C Bus und 2x UART. Für sicherheitskritische Netzwerkinstallationen ist zudem ein Trusted Platform Modul (TPM) integriert.

congatec bietet umfassende Board Support Packages für alle aktuellen 64 Bit Microsoft Windows Varianten sowie für Red Hat Enterprise Linux Server. Das Design-In wird zudem durch umfassendes Zubehör – wie Kühllösungen und das neue COM Express Typ 7 Evaluierungs-Carrierboard – erleichtert.

Die neuen conga-B7AC COM Express Typ 7 Server-on-Modules können in folgenden Standardkonfigurationen bestellt werden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prozessor** |  | **Cores** |  | **Smart Cache [MB]** |  | **Takt/ Burst****[GHz]** |  | **TDP [W]** |
| **Intel® Atom™ C3958** |  | **16** |  | **16** |  | **2.0 / TBD** |  | **31** |
| **Intel® Atom™ C3858** |  | **12** |  | **12** |  | **2.0 / TBD** |  | **25** |
| **Intel® Atom™ C3758** |  | **8** |  | **16** |  | **2.2 / TBD** |  | **25** |
| **Intel® Atom™ C3558** |  | **4** |  | **8** |  | **2.2 / TBD** |  | **16** |
| **Intel® Atom™ C3538** |  | **4** |  | **8** |  | **2.1 / TBD** |  | **15** |
| **Intel® Atom™ C3808** |  | **12** |  | **12** |  | **2.0 / TBD** |  | **25** |
| **Intel® Atom™ C3708** |  | **8** |  | **16** |  | **1.7 / TBD** |  | **17** |
| **Intel® Atom™ C3508** |  | **4** |  | **8** |  | **1.5 / TBD** |  | **11** |

Weitere Informationen zu den neuen conga-B7AC Server-on-Modulen unter: <http://www.congatec.com/de/produkte/com-express-typ7/conga-b7ac.html>

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Atom, Xeon sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*